

Systemy klejenia okładzin ceramicznych i kamiennych

Przewodnik

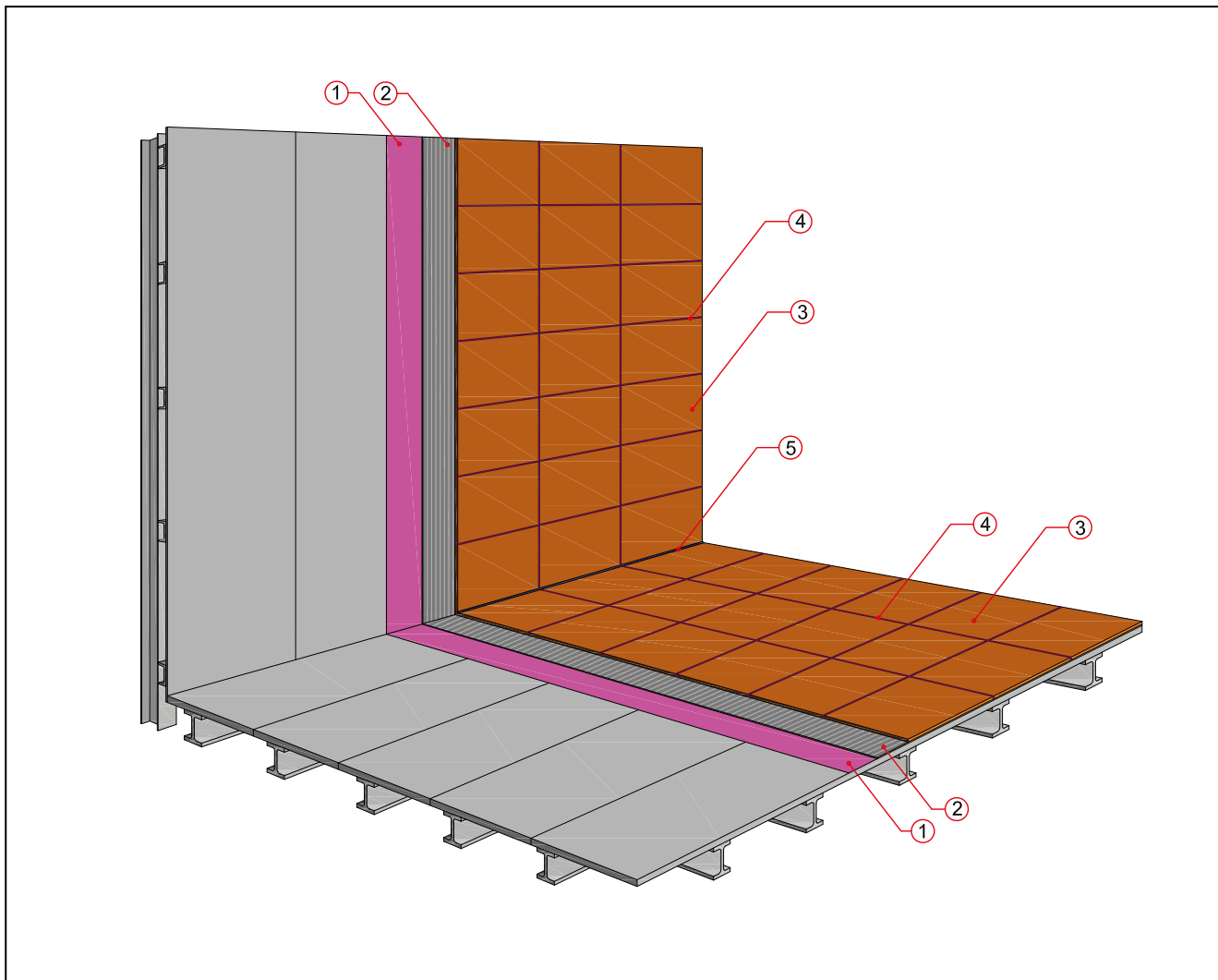


A brand of

BASF

We create chemistry

4. Płytki na podłożu stalowym wewnątrz



Nr	Elementy systemu	Produkt PCI	Opis produktu
1	Grunt	PCI Gisoground 404	Grunt dyspersyjny do podłoży chłonnych i niechłonnych
2	Klej do płytek	PCI Nanolight	Uniwersalny elastyczny klej cementowy
3	Płytki		
4	Fuga	PCI Nanofug Premium	Elastyczna fuga cementowa
5	Uszczelniacz	PCI Silcofug E	1-składnikowy uszczelniacz silikonowy

Opis obiektu - warunki eksploatacji - obciążenia

Okładziny płytowe ceramiczne na niepodlegających dużym drganiom harmonicznym podłożach stalowych we wnętrzach występują niekiedy w obiektach przemysłowych lub użyteczności publicznej. Elementy stalowe mają postać kształtowników walcowanych lub blach o znacznej grubości. Często sąsiadują one z typowymi podłożami (beton, mur ceglany). Obciążenia mechaniczne mogą być bardzo zróżnicowane: ruch pieszy, ruch kołowy, masa elementów wyposażenia itp. Zakłada się brak znacznych zmian temperatury czy obciążeń chemicznych. Zastosowane materiały okładzinowe, głównie kleje mają za zadanie przede wszystkim zapewnić wysoką przyczepność płytek do trudnego podłoża, jakim jest stal. W dużych pomieszczeniach może wystąpić konieczność dylatowania powierzchni. Poniższe zalecenia odnoszą się do przykładowego rozwiązania, prezentowanego na schemacie powyżej.

Podłoże

Zakłada się, iż podłożem jest stal: głównie blachy i kształtowniki walcowane w postaci słupów, rygli, belek stropowych itp. Elementy te posiadają wymagane zabezpieczenie antykorozyjne, są czyste (przede wszystkim odtłuszczone) i nie wymagają stosowania warstw wyrównawczych.

Wykonawstwo

A. GRUNTOWANIE

Do gruntowania stosuje się środek dyspersyjny **PCI Gisogrund 404**.

B. WYKLEJENIE PŁYTEK

Do mocowania okładziny płytkowej należy stosować uniwersalny elastyczny klej cementowy klej **PCI Nanolight**. Na posadzkach, które będą poddawane znacznym obciążeniom mechanicznym, wynikającym np. z intensywnego ruchu wózków lub pochodzącym od ciężkich mebli, zaleca się przyklejanie płytek metodą kombinowaną.

C. SPOINOWANIE PŁYTEK

Spoinowanie najlepiej wykonać elastyczną cementową fugą: **PCI Nanofug Premium**. Szerokość fug zależy od rozmiaru płytek i winna być określona przez projektanta w projekcie rozmieszczenia elementów okładziny.

W dylatacjach obwodowych posadzki przy ścianach i słupach, a także w ewentualnych dylatacjach ścian, należy wypełnić spoiny uszczelniaczem silikonowym **PCI Silcofug E**. W ewentualnych dylatacjach w powierzchni posadzki zaleca się wypełnienie uszczelniaczem poliuretanowym **PCI Elritan 140**, gruntując go od strony płytek środkiem **PCI Elastoprimer 145**. Pod uszczelniaczem umieścić wałek dylatacyjny, np. **DIN Polyband 08**.

Uwagi

Wskazane rozwiązanie należy traktować jako przykładowe. Każdorazowo należy je adaptować do konkretnej konstrukcji i warunków eksploatacyjnych, opierając się zasadach wiedzy budowlanej. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z regionalnym Doradcą Technicznym PCI.